

SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Сквозная шина, встроенная в монтажную рейку, для модульной системы корпусов для электроники

Благодаря непрерывному и гибкому системному решению, встроенная в монтажную рейку шина, которая в модульных установках осуществляет электроснабжение, соединение и распределение, позволяет заменить дорогостоящую индивидуальную проводку.

Системная шина надежно интегрирована в 35-миллиметровую стандартную рейку. При изготовлении узлов, с помощью метода пайки Reflow контактный модуль шины для поверхностного монтажа можно обрабатывать в полностью автоматическом режиме. Износостойкие позолоченные поверхности контактов гарантируют неизменно надежный контакт для корпусов любой ширины.

- **Безграничная масштабируемость** - системное решение по соединению независимо от монтажной ширины - от тонкой компактной конструкции 6 мм до крупногабаритного корпуса 67 мм.
- **Удобная для обслуживания установка** - простая замена модуля также в целых модульных системах без помех для соседних модулей.
- **Всеобщая интеграция** - непрерывная системная шина: надежно встроена в 35-миллиметровую стандартную монтажную рейку.

• Максимальная эксплуатационная готовность

- пять сдвоенных изогнутых контактов с полным гальваническим покрытием и частичной позолотой обеспечивают постоянный контакт с монтажной рейкой с встроенной шиной. Фланцы под пайку THR гарантируют стабильное соединение с печатной платой.

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Шина - контактный блок для CH20M12-67, Центральный фланец под пайку, Соединение ТНТ/THR под пайку, Количество полюсов: 5, 180°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, позолоченный, черный
Номер для заказа	1155870000
Тип	SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX
GTIN (EAN)	4032248942510
Кол.	78 Шт.
Продуктовое отношение	UL:
Упаковка	Ящик

Дата создания 7 апреля 2021 г. 5:46:34 CEST

SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	5,9 мм	Высота (в дюймах)	0,232 inch
Длина	24 мм	Длина (в дюймах)	0,945 inch
Масса нетто	3,13 g	Ширина	16,3 мм
Ширина (в дюймах)	0,642 inch		

Данные о материалах

Группа изоляционного материала	IIIa	Изоляционный материал	LCP
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	>= 175		

Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	>= 175	Прочность изоляции	$\geq 10^8 \Omega$
Moisture Level (MSL)	1	Поверхность контакта	позолоченный
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-30 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984

Общие данные

Вид защиты	IP20	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011
Цветовой код	черный		

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
------------------	--

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E60693

SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

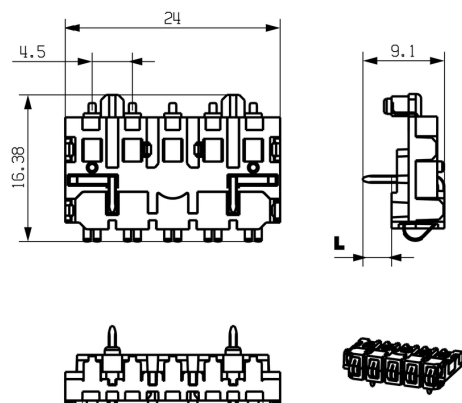
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN

SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX

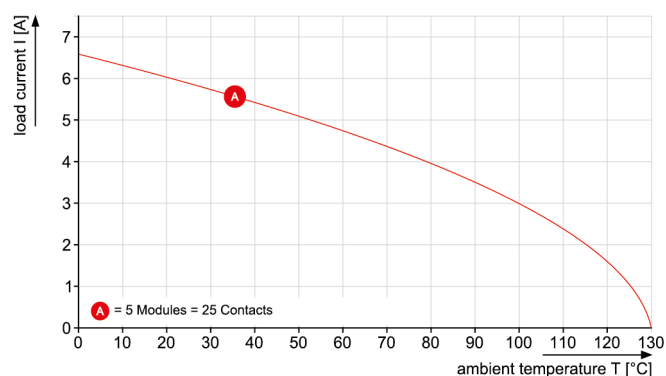
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CH20M22-Bus



Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

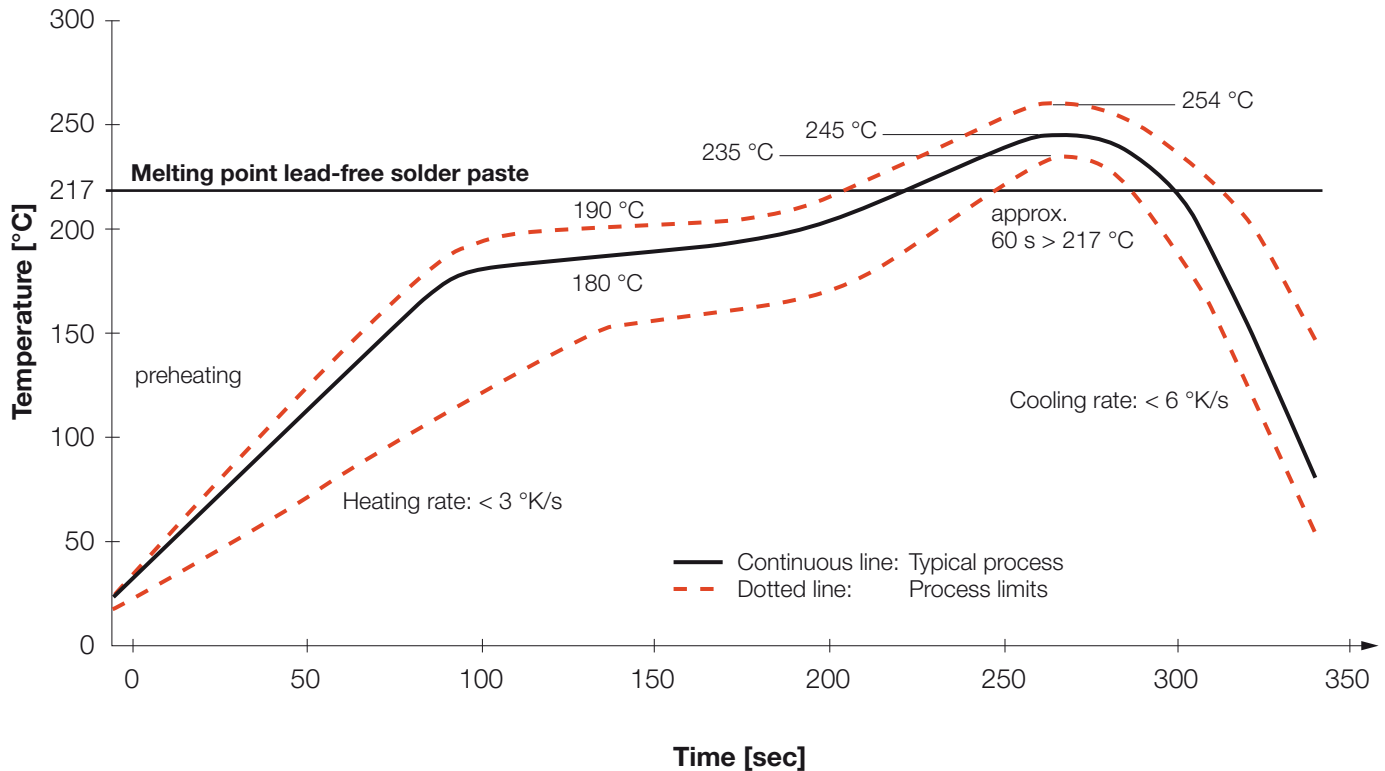
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.